

# 2024-2030年中国集成电路 与关键材料行业“专精特新”行业发展态势与发展趋势研究

## 报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

[www.cction.com](http://www.cction.com)

# 一、报告报价

《2024-2030年中国集成电路装备与关键材料行业“专精特新”行业发展态势与发展趋势研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202406/461195.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

中企顾问网发布的《2024-2030年中国集成电路装备与关键材料行业“专精特新”行业发展态势与发展趋势研究报告》报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及共研分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用共研自主建立的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，是企业布局煤炭综采设备后市场服务行业的重要决策参考依据。

报告目录：

第1章：中国集成电路装备与关键材料行业“专精特新”发展概述

1.1 集成电路装备与关键材料行业的界定

1.1.1 集成电路装备与关键材料的界定

1.1.2 集成电路装备与关键材料所处产业链环节

1.1.3 集成电路装备与关键材料行业分类

（1）集成电路设备

（2）集成电路材料

1.1.4 集成电路装备与关键材料所属国民经济行业分类

1.2 “专精特新”概念界定

1.2.1 “专精特新”概念解读

1.2.2 “专精特新”相关概念辨析

（1）“专精特新”企业分类

（2）“专精特新”相关概念辨析

1) 制造业单项冠军企业

2) 隐形冠军企业

3) 三类企业异同分析

1.3 “专精特新”发展背景及发展地位分析

1.3.1 “专精特新”发展背景-内因分析

（1）中国中小企业发展现状

1) 中小企业数量规模

2) 中小企业经营效益

3) 中小企业运行情况

- (2) 中国制造业短板突出，大而不强
- (3) 服务“国内国际双循环”发展格局
- 1.3.2 “专精特新”发展背景-外因分析
  - (1) 全球贸易摩擦加剧、外部环境动荡
  - (2) 中国高科技发展遭遇“卡脖子”
- 1.3.3 “专精特新”发展地位分析
- 1.4 本报告研究范围界定说明
- 1.5 本报告数据来源及统计标准说明

## 第2章：全球及中国集成电路装备与关键材料行业发展现状分析

- 2.1 全球集成电路装备与关键材料行业发展现状
  - 2.1.1 全球集成电路装备与关键材料行业发展规模
  - 2.1.2 全球集成电路装备与关键材料行业结构
    - (1) 全球集成电路装备行业结构
    - (2) 全球集成电路关键材料行业结构
  - 2.1.3 全球集成电路装备与关键材料行业区域发展格局
    - (1) 全球集成电路产业迁移状况
      - 1) 全球集成电路产业迁移情况
      - 2) 全球集成电路产业迁移的内在价值
    - (2) 全球集成电路装备与关键材料行业区域发展格局分析
  - 2.1.4 全球集成电路装备与关键材料行业企业竞争格局
    - (1) 全球集成电路装备企业竞争格局
    - (2) 全球集成电路材料企业竞争格局
- 2.2 中国集成电路装备与关键材料行业发展现状
  - 2.2.1 中国集成电路装备与关键材料行业发展规模
  - 2.2.2 中国集成电路装备与关键材料行业结构
    - (1) 中国集成电路装备行业结构
    - (2) 中国集成电路关键材料行业结构
  - 2.2.3 中国集成电路装备与关键材料行业企业竞争格局
    - (1) 中国集成电路装备企业竞争格局
    - (2) 中国集成电路材料企业竞争格局
- 2.3 中国集成电路装备与关键材料行业技术水平及国产化现状

### 2.3.1 中国集成电路装备与关键材料行业技术发展现状

#### (1) 集成电路装备与关键材料行业技术进展

#### (2) 集成电路装备与关键材料行业专利申请情况

##### 1) 集成电路装备相关专利申请情况

##### 2) 集成电路关键材料相关专利申请情况

#### (3) 集成电路装备与关键材料行业技术研发趋势

##### 1) 集成电路装备技术趋势

##### 2) 集成电路关键材料技术趋势

### 2.3.2 中国集成电路装备与关键材料行业国产化发展现状

#### (1) 集成电路装备与关键材料行业国产化率分析

##### 1) 集成电路装备

##### 2) 集成电路关键材料

#### (2) 集成电路装备与关键材料行业本土企业布局

##### 1) 集成电路装备领域本土企业布局

##### 2) 集成电路关键材料领域本土企业布局

### 2.4 中国集成电路装备与关键材料行业发展机遇与挑战分析

## 第3章：中国集成电路装备与关键材料行业“专精特新”政策环境及投融资环境分析

### 3.1 中国集成电路装备与关键材料行业“专精特新”政策环境分析

#### 3.1.1 国家层面集成电路装备与关键材料行业发展相关政策及规划汇总解读

##### (1) 集成电路装备与关键材料行业发展相关政策汇总及解读

##### (2) 集成电路装备与关键材料行业发展相关规划汇总及解读

##### (3) 集成电路装备与关键材料行业相关规划发展历程

#### 3.1.2 国家层面集成电路装备与关键材料行业“专精特新”相关政策汇总解读

##### (1) 中国集成电路装备与关键材料行业“专精特新”发展政策解读

##### (2) 集成电路装备与关键材料行业“专精特新”重点政策解读

##### 1) 《2006-2020年国家信息化发展战略》

##### 2) 《关于印发“十四五”促进中小企业发展规划的通知》

##### 3) 《第十三届全国人民代表大会第五次会议关于2021年中央和地方预算执行情况与2022年中央和地方预算的决议》

#### 3.1.3 国家“十四五”规划对集成电路装备与关键材料行业发展的影响分析

- 3.1.4 “国内国际双循环”战略的提出对集成电路装备与关键材料“专精特新”的影响分析
- 3.1.5 集成电路装备与关键材料行业“专精特新”发展的政策机遇分析
- 3.2 中国集成电路装备与关键材料行业“专精特新”投融资环境分析
  - 3.2.1 中国集成电路装备与关键材料行业“专精特新”领域主要资金来源和融资方式
  - 3.2.2 中国集成电路装备与关键材料行业“专精特新”领域投融资主体
  - 3.2.3 中国集成电路装备与关键材料行业“专精特新”领域投融资事件汇总
  - 3.2.4 中国集成电路装备与关键材料行业“专精特新”领域国家大基金投资情况
    - (1) 国家大基金介绍
    - (2) 国家大基金一期投资分析
      - 1) 国家大基金一期投资行业结构
      - 2) 国家大基金一期投资企业结构
    - (3) 国家大基金二期投资情况
  - 3.2.5 中国集成电路装备与关键材料行业“专精特新”领域投融资机遇分析
    - (1) 集成电路装备与关键材料行业“专精特新”财税扶持力度
    - (2) 集成电路装备与关键材料行业“专精特新”信贷支持政策
    - (3) 集成电路装备与关键材料行业“专精特新”市场化融资渠道
    - (4) 北京交易所成立带来的发展机遇分析
      - 1) 打造服务创新型中小企业主阵地
      - 2) 促进中小企业与资本市场有机结合
      - 3) 首批上市企业“专精特新”特点突出
- 3.3 中国集成电路装备与关键材料行业“专精特新”发展战略支撑及保障

#### 第4章：中国集成电路装备与关键材料行业“专精特新”企业培育方案及培育现状解读

- 4.1 中国集成电路装备与关键材料行业“专精特新”企业培育方案解读
  - 4.1.1 集成电路装备与关键材料行业国家级“专精特新”企业培育目的
  - 4.1.2 集成电路装备与关键材料行业国家级“专精特新”企业培育对象
  - 4.1.3 集成电路装备与关键材料行业国家级“专精特新”企业培育方向
  - 4.1.4 集成电路装备与关键材料行业国家级“专精特新”企业培育措施
  - 4.1.5 集成电路装备与关键材料行业“专精特新”“小巨人”企业奖励标准

## 4.2 中国集成电路装备与关键材料行业专精特新“小巨人”企业申报条件及流程解读

### 4.2.1 集成电路装备与关键材料行业专精特新“小巨人”企业申报-基本条件

### 4.2.2 集成电路装备与关键材料行业专精特新“小巨人”企业申报-专项条件

### 4.2.3 集成电路装备与关键材料行业专精特新“小巨人”企业申报-分类条件

### 4.2.4 集成电路装备与关键材料行业专精特新“小巨人”企业申报流程解读

## 4.3 中国集成电路装备与关键材料行业专精特新“小巨人”企业培育现状分析

### 4.3.1 全国专精特新“小巨人”企业培育现状

#### (1) 专精特新“小巨人”企业培育进展

##### 1) 全国培育数量

##### 2) 31省市培育状况

#### (2) 专精特新“小巨人”企业培育特征

#### (3) 专精特新“小巨人”企业行业分布

### 4.3.2 集成电路装备与关键材料行业专精特新“小巨人”企业培育现状

#### (1) 集成电路装备与关键材料行业专精特新“小巨人”企业培育进展

##### 1) 集成电路装备与关键材料行业专精特新“小巨人”数量占比

##### 2) 集成电路装备与关键材料行业专精特新“小巨人”企业经营现状

#### (2) 集成电路装备与关键材料行业专精特新“小巨人”企业培育特征

##### 1) 集成电路装备与关键材料行业专精特新“小巨人”上市企业比例情况

##### 2) 集成电路装备与关键材料行业专精特新“小巨人”企业行业分布情况

## 第5章：中国集成电路装备与关键材料产业链全景梳理及“专精特新”鼓励布局方向

### 5.1 中国集成电路装备与关键材料产业结构属性（产业链）分析

#### 5.1.1 中国集成电路装备与关键材料产业链结构梳理

##### (1) 中国集成电路装备产业链结构梳理

##### (2) 中国集成电路关键材料产业链结构梳理

#### 5.1.2 中国集成电路装备与关键材料产业链生态图谱

##### (1) 中国集成电路装备产业链生态图谱

##### (2) 中国集成电路关键材料产业链生态图谱

### 5.2 中国集成电路装备与关键材料产业价值属性（价值链）分析

#### 5.2.1 中国集成电路装备与关键材料行业成本结构分析

(1) 中国集成电路装备成本结构分析

(2) 中国集成电路关键材料结构分析

5.2.2 中国集成电路装备与关键材料行业价值链分析

5.3 中国集成电路装备与关键材料行业发展痛点分析

5.4 中国集成电路装备与关键材料产业链“专精特新”鼓励布局方向

第6章：中国集成电路装备与关键材料产业链环节“专精特新”布局状况研究

6.1 中国集成电路装备与关键材料行业之光刻机“专精特新”布局状况研究

6.1.1 中国集成电路装备与关键材料行业之光刻机发展现状分析

(1) 集成电路光刻机市场发展规模

(2) 集成电路光刻机技术发展现状

1) 最新技术布局

2) 专利情况

(3) 集成电路光刻机国产化发展现状

1) 国产化率分析

2) 本土企业布局

6.1.2 中国集成电路装备与关键材料行业之光刻机发展痛点分析

6.1.3 中国集成电路装备与关键材料行业之光刻机“专精特新”市场培育现状

(1) 集成电路光刻机“专精特新”企业培育规模

(2) 集成电路光刻机“专精特新”市场培育特征

6.1.4 中国集成电路装备与关键材料行业之光刻机市场竞争格局分析

(1) 集成电路光刻机市场企业竞争格局分析

(2) 集成电路光刻机市场区域竞争格局分析

6.1.5 中国集成电路装备与关键材料行业之光刻机发展前景及趋势分析

6.2 中国集成电路装备与关键材料行业之刻蚀设备“专精特新”布局状况研究

6.2.1 中国集成电路装备与关键材料行业之刻蚀设备发展现状分析

(1) 集成电路刻蚀设备市场发展规模

(2) 集成电路刻蚀设备技术发展现状

1) 最新技术布局

2) 专利情况

(3) 集成电路刻蚀设备国产化发展现状

1) 国产化率分析

## 2) 本土企业布局

### 6.2.2 中国集成电路装备与关键材料行业之刻蚀设备发展痛点分析

### 6.2.3 中国集成电路装备与关键材料行业之刻蚀设备“专精特新”市场培育现状

(1) 集成电路刻蚀设备“专精特新”企业培育规模

(2) 集成电路刻蚀设备“专精特新”市场培育特征

(3) 集成电路刻蚀设备“专精特新”产品培育情况

### 6.2.4 中国集成电路装备与关键材料行业之刻蚀设备市场竞争格局分析

(1) 集成电路刻蚀设备市场企业竞争格局分析

(2) 集成电路刻蚀设备市场区域竞争格局分析

### 6.2.5 中国集成电路装备与关键材料行业之刻蚀设备发展前景及趋势分析

## 6.3 中国集成电路装备与关键材料行业之薄膜沉积设备“专精特新”布局状况研究

### 6.3.1 中国集成电路装备与关键材料行业之薄膜沉积设备发展现状分析

(1) 集成电路薄膜沉积设备市场发展规模

(2) 集成电路薄膜沉积设备技术发展现状

#### 1) 最新技术布局

#### 2) 专利情况

(3) 集成电路薄膜沉积设备国产化发展现状

#### 1) 国产化率分析

#### 2) 本土企业布局

### 6.3.2 中国集成电路装备与关键材料行业之薄膜沉积设备发展痛点分析

### 6.3.3 中国集成电路装备与关键材料行业之薄膜沉积设备“专精特新”市场培育现状

(1) 集成电路薄膜沉积设备“专精特新”企业培育规模

(2) 集成电路薄膜沉积设备“专精特新”市场培育特征

### 6.3.4 中国集成电路装备与关键材料行业之薄膜沉积设备市场竞争格局分析

(1) 集成电路薄膜沉积设备市场企业竞争格局分析

(2) 集成电路薄膜沉积设备市场区域竞争格局分析

### 6.3.5 中国集成电路装备与关键材料行业之薄膜沉积设备发展前景及趋势分析

## 6.4 中国集成电路装备与关键材料行业之硅片“专精特新”布局状况研究

### 6.4.1 中国集成电路装备与关键材料行业之硅片发展现状分析

(1) 集成电路硅片市场发展规模

(2) 集成电路硅片技术发展现状

1) 最新技术布局

2) 专利情况

(3) 集成电路硅片国产化发展现状

1) 国产化率分析

2) 本土企业布局

6.4.2 中国集成电路装备与关键材料行业之硅片发展痛点分析

6.4.3 中国集成电路装备与关键材料行业之硅片“专精特新”市场培育现状

(1) 集成电路硅片“专精特新”企业培育规模

(2) 集成电路硅片“专精特新”市场培育特征

(3) 集成电路硅片“专精特新”产品培育情况

6.4.4 中国集成电路装备与关键材料行业之硅片市场竞争格局分析

(1) 集成电路硅片市场企业竞争格局分析

(2) 集成电路硅片市场区域竞争格局分析

6.4.5 中国集成电路装备与关键材料行业之硅片发展前景及趋势分析

6.5 中国集成电路装备与关键材料行业之光刻胶“专精特新”布局状况研究

6.5.1 中国集成电路装备与关键材料行业之光刻胶发展现状分析

(1) 集成电路光刻胶市场发展规模

(2) 集成电路光刻胶技术发展现状

1) 最新技术布局

2) 专利情况

(3) 集成电路光刻胶国产化发展现状

1) 国产化率分析

2) 本土企业布局

6.5.2 中国集成电路装备与关键材料行业之光刻胶发展痛点分析

6.5.3 中国集成电路装备与关键材料行业之光刻胶“专精特新”市场培育现状

(1) 集成电路光刻胶“专精特新”企业培育规模

(2) 集成电路光刻胶“专精特新”市场培育特征

(3) 集成电路光刻胶“专精特新”产品培育情况

6.5.4 中国集成电路装备与关键材料行业之光刻胶市场竞争格局分析

(1) 集成电路光刻胶市场企业竞争格局分析

(2) 集成电路光刻胶市场区域竞争格局分析

6.5.5 中国集成电路装备与关键材料行业之光刻胶发展前景及趋势分析

## 第7章：中国集成电路装备与关键材料行业区域发展格局及“专精特新”发展研究

### 7.1 中国集成电路装备与关键材料产业资源31省市分布状况

#### 7.1.1 中国集成电路装备与关键材料产业研发平台资源分布状况

#### 7.1.2 中国集成电路装备与关键材料产业创新资源分布状况

### 7.2 中国集成电路装备与关键材料行业企业数量31省市分布

#### 7.2.1 中国集成电路装备企业数量31省市分布

#### 7.2.2 中国集成电路关键材料企业数量31省市分布

### 7.3 中国集成电路装备与关键材料行业区域发展格局分析

#### 7.3.1 中国集成电路装备与关键材料产业园区发展情况

#### 7.3.2 中国集成电路装备与关键材料产业整体空间布局

### 7.4 中国31省市集成电路装备与关键材料行业“专精特新”政策环境分析

#### 7.4.1 31省市集成电路装备与关键材料行业发展政策汇总及解读

#### 7.4.2 31省市集成电路装备与关键材料行业“专精特新”政策汇总及解读

##### (1) 31省市“专精特新”重点政策汇总及解读

##### (2) 集成电路装备与关键材料行业31省市“专精特新”发展重点

### 7.5 中国31省市集成电路装备与关键材料行业“专精特新”企业培育方案及申报条件

#### 7.5.1 集成电路装备与关键材料行业省市级“专精特新”企业培育方案解读

##### (1) 31省市“专精特新”企业认定标准情况

##### 1) 31省市“专精特新”企业认定标准汇总

##### 2) 31省市“专精特新”企业认定标准重要指标对比

##### (2) 省级“专精特新”企业培育方案解读

##### 1) 培育目的

##### 2) 培育对象

##### 3) 培育内容

##### 4) 推进措施

##### (3) 市级“专精特新”企业培育方案解读

##### 1) 培育目的

##### 2) 培育对象

##### 3) 培育内容

##### 4) 推进措施

7.5.2 集成电路装备与关键材料行业省市级“专精特新”企业奖励标准

7.5.3 集成电路装备与关键材料行业省市级“专精特新”企业申报条件解读

(1) 省级“专精特新”企业申报条件

1) 基本条件

2) 专项条件

(2) 市级“专精特新”企业申报条件

1) 基本条件

2) 专项条件

7.5.4 集成电路装备与关键材料行业省市级“专精特新”企业申报流程解读

7.6 中国31省市集成电路装备与关键材料行业“专精特新”市场培育现状

7.6.1 31省市集成电路装备与关键材料行业“专精特新”企业培育规模

7.6.2 31省市集成电路装备与关键材料行业“专精特新”市场培育格局

7.6.3 31省市集成电路装备与关键材料行业“专精特新”市场培育特征

(1) 行业“专精特新”市场培育政策倾向

(2) 行业“专精特新”市场培育细分行业偏向

第8章：中国集成电路装备与关键材料行业代表性“小巨人”企业布局对比及案例研究

8.1 中国集成电路装备与关键材料行业代表性“小巨人”企业布局对比

8.2 中国集成电路装备与关键材料行业代表性“小巨人”企业布局案例研究

8.2.1 天津中环半导体股份有限公司

(1) 企业基本信息分析

(2) 企业发展状况

1) 经营状况

2) 业务架构

3) 销售网络

(3) 企业集成电路装备与关键材料业务类型及产品介绍

(4) 企业集成电路装备与关键材料产业链布局状况

(5) 企业集成电路装备与关键材料业务“专精特新”布局动向

(6) 企业集成电路装备与关键材料业务布局优劣势分析

8.2.2 江苏南大光电材料股份有限公司

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业发展状况

- 1) 经营状况
- 2) 业务架构
- 3) 销售网络

(3) 企业集成电路装备与关键材料业务类型及产品介绍

- 1) 企业集成电路关键原材料业务布局介绍
- 2) 企业集成电路关键原材料生产能力分析

(4) 企业集成电路装备与关键材料产业链布局状况

(5) 企业集成电路装备与关键材料业务“专精特新”布局动向

- 1) 企业产业研发项目
- 2) 企业产业研发投入情况

(6) 企业集成电路装备与关键材料业务布局优劣势分析

8.2.3 江阴江化微电子材料股份有限公司

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业发展状况

- 1) 经营状况
- 2) 业务架构
- 3) 销售网络

(3) 企业集成电路装备与关键材料业务类型及产品介绍

(4) 企业集成电路装备与关键材料产业链布局状况

(5) 企业集成电路装备与关键材料业务“专精特新”布局动向

- 1) 企业产业研发投入情况
- 2) 企业产业研发技术分析

(6) 企业集成电路装备与关键材料布局优劣势分析

8.2.4 福建阿石创新材料股份有限公司

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业发展状况

- 1) 经营状况
- 2) 业务架构
- 3) 销售网络

(3) 企业集成电路装备与关键材料业务类型及产品介绍

(4) 企业集成电路装备与关键材料产业链布局状况

(5) 企业集成电路装备与关键材料业务“专精特新”布局动向

(6) 企业集成电路装备与关键材料业务布局优劣势分析

#### 8.2.5 安集微电子科技（上海）股份有限公司

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业发展状况

1) 经营状况

2) 业务架构

3) 销售网络

(3) 企业集成电路装备与关键材料业务类型及产品介绍

(4) 企业集成电路装备与关键材料产业链布局状况

(5) 企业集成电路装备与关键材料业务“专精特新”布局动向

(6) 企业集成电路装备与关键材料业务布局优劣势分析

#### 8.2.6 杭州长川科技股份有限公司

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业发展状况

1) 经营状况

2) 业务架构

3) 销售网络

(3) 企业集成电路装备与关键材料业务类型及产品介绍

(4) 企业集成电路装备与关键材料产业链布局状况

(5) 企业集成电路装备与关键材料业务“专精特新”布局动向

(6) 企业集成电路装备与关键材料业务布局优劣势分析

#### 8.2.7 上海至纯洁净系统科技股份有限公司

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业发展状况

1) 经营状况

2) 业务架构

3) 销售网络

(3) 企业集成电路装备与关键材料业务类型及产品介绍

(4) 企业集成电路装备与关键材料产业链布局状况

(5) 企业集成电路装备与关键材料业务“专精特新”布局动向

(6) 企业集成电路装备与关键材料业务布局优劣势分析

## 8.2.8 沈阳芯源微电子设备股份有限公司

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业发展状况

1) 经营状况

2) 业务架构

3) 销售网络

(3) 企业集成电路装备与关键材料业务类型及产品介绍

(4) 企业集成电路装备与关键材料产业链布局状况

(5) 企业集成电路装备与关键材料业务“专精特新”布局动向

(6) 企业集成电路装备与关键材料业务布局优劣势分析

## 8.2.9 多氟多化工股份有限公司

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业发展状况

1) 经营状况

2) 业务架构

3) 销售网络

(3) 企业集成电路装备与关键材料业务类型及产品介绍

(4) 企业集成电路装备与关键材料产业链布局状况

(5) 企业集成电路装备与关键材料业务“专精特新”布局动向

(6) 企业集成电路装备与关键材料业务布局优劣势分析

## 8.2.10 浙江晶盛机电股份有限公司

(1) 企业发展历程及基本信息

(2) 企业发展状况

1) 经营状况

2) 业务架构

3) 销售网络

(3) 企业集成电路装备与关键材料业务类型及产品介绍

(4) 企业集成电路装备与关键材料产业链布局状况

(5) 企业集成电路装备与关键材料业务“专精特新”布局动向

(6) 企业集成电路装备与关键材料业务布局优劣势分析

## 第9章：中国集成电路装备与关键材料行业“专精特新”发展趋势预判及前景预测

9.1 中国集成电路装备与关键材料行业市场前景预测

9.2 中国集成电路装备与关键材料行业“专精特新”发展趋势预判

9.2.1 中国集成电路装备与关键材料行业发展趋势

9.2.2 中国集成电路装备与关键材料领域“专精特新”发展趋势

(1) 整体发展趋势

(2) 细分领域发展趋势

9.3 中国集成电路装备与关键材料行业“专精特新”发展前景预测

第10章：中国集成电路装备与关键材料行业“专精特新”投资特性及投资机会分析

10.1 中国集成电路装备与关键材料行业“专精特新”投资特性分析

10.1.1 中国集成电路装备与关键材料行业“专精特新”投资壁垒分析

10.1.2 中国集成电路装备与关键材料行业“专精特新”投资风险预警及防范

(1) 周期性风险

(2) 政策风险

(3) 技术风险

(4) 行业竞争风险

10.2 中国集成电路装备与关键材料行业“专精特新”投资价值评估

10.3 中国集成电路装备与关键材料行业“专精特新”投资机会分析

10.3.1 产业链薄弱环节投资机会

(1) 上游零部件环节

(2) 下游集成电路环节

10.3.2 区域市场投资机会

10.3.3 细分市场投资机会

第11章：中国集成电路装备与关键材料行业“专精特新”投资策略及发展建议

11.1 中国集成电路装备与关键材料行业“专精特新”投资策略

11.2 中国集成电路装备与关键材料行业“专精特新”发展建议

11.2.1 中国集成电路装备与关键材料行业“专精特新”企业发展建议

11.2.2 中国集成电路装备与关键材料行业“专精特新”政府发展建议

图表目录

图表1：集成电路装备与关键材料在集成电路产业链所处环节

图表2：集成电路设备的分类

图表3：集成电路材料分类

图表4：《国民经济行业分类与代码》中集成电路装备与关键材料行业归属

图表5：“专精特新”特征分析

图表6：“专精特新”企业分类

图表7：制造业单项冠军企业申报条件

图表8：隐形冠军标准条件

图表9：“专精特新”相似概念辨析

图表10：2019-2023年中国登记在册企业数量（单位：万户）

图表11：2019-2023年中国规模以上工业中小企业营业收入、利润总额增长率（单位：%）

图表12：中小企业对中国经济发展的贡献（单位：%）

图表13：2019-2023年中国中小企业发展指数（SMEDI）

图表14：2012-2021年中国制造业增加值（单位：万亿元）

图表15：“国内国际双循环”发展格局

图表16：2020-2022年全球经贸摩擦指数月度走势

图表17：中国被“卡脖子”的35项关键技术

图表18：“专精特新”发展历程

图表19：本报告研究范围界定

图表20：本报告数据来源及统计标准说明

图表21：2016-2021年全球半导体设备及关键材料行业市场规模（单位：亿美元）

图表22：2021年全球半导体设备行业市场结构（单位：%）

图表23：2016-2021年全球半导体关键材料行业结构（单位：%）

图表24：全球集成电路产业迁移分析

图表25：全球集成电路产业迁移空间图

图表26：2020-2021年全球半导体设备行业区域发展格局（单位：%）

图表27：2020-2021年全球半导体材料行业区域发展格局（单位：%）

图表28：2021年全球集成电路设备商TOP10（按销售额）（单位：亿美元）

图表29：2022年全球集成电路设备商TOP10/垂直领域设备商TOP7

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202406/461195.html>